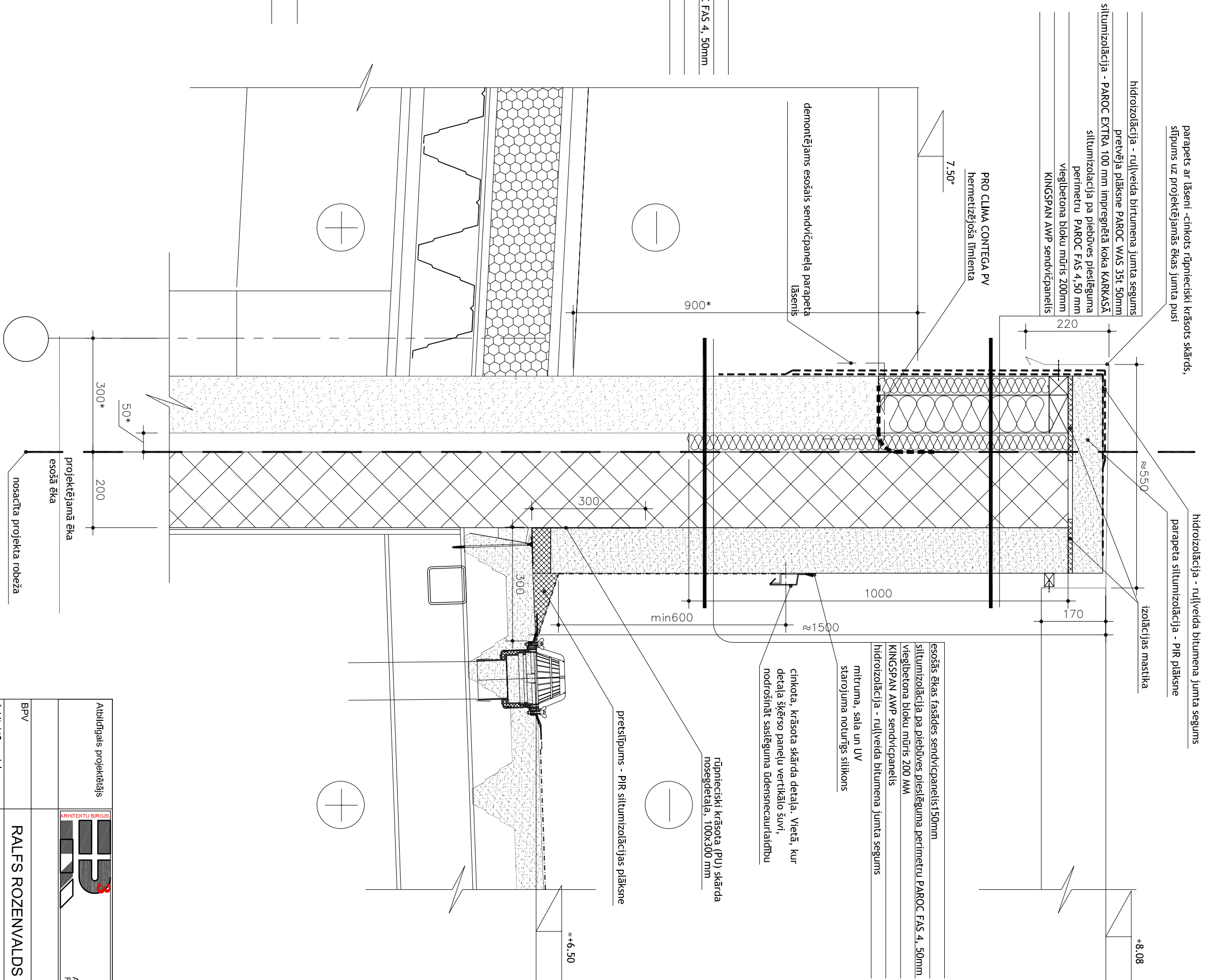
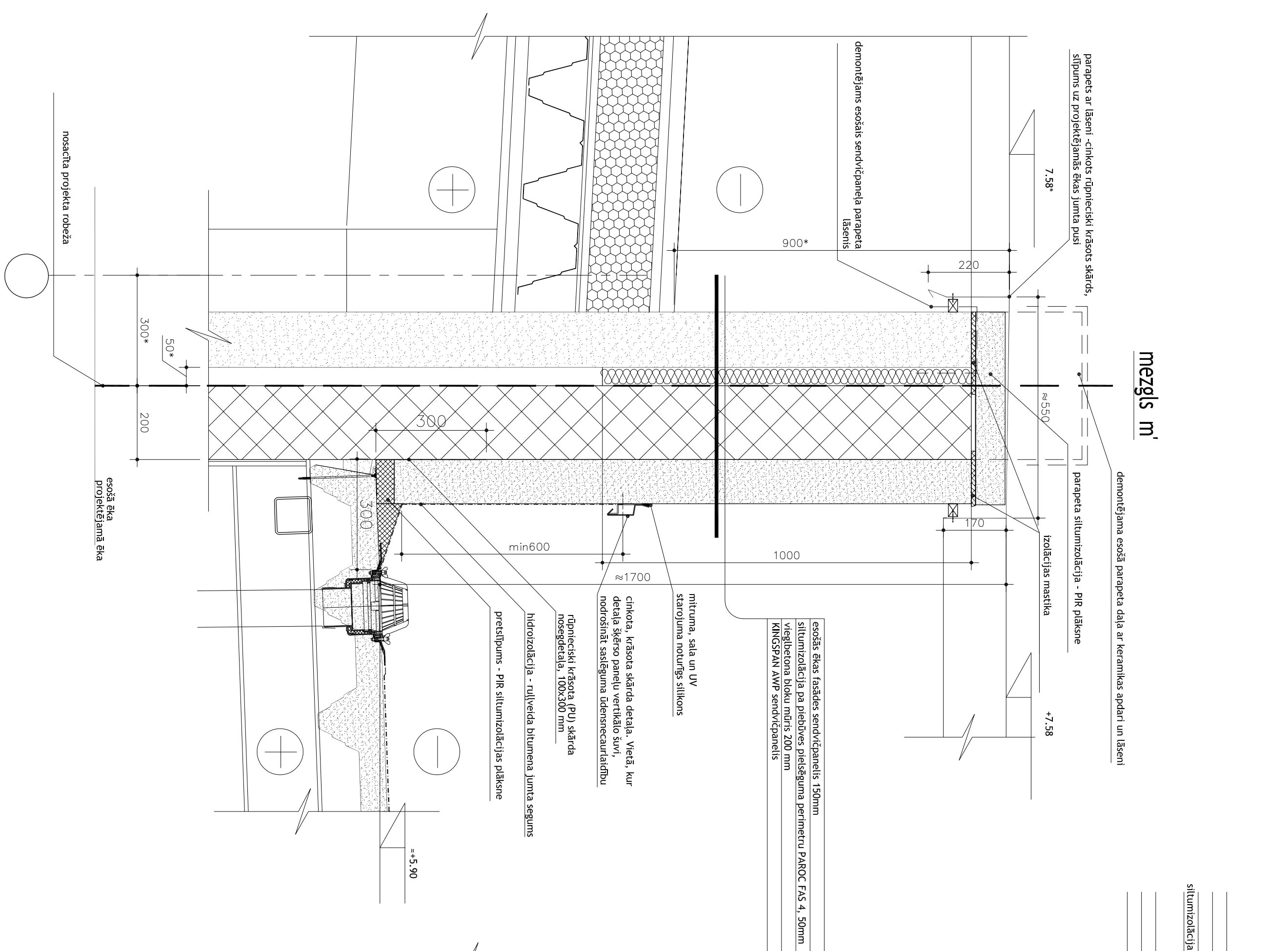



mezgls m"



PIEZĪMES

1. Visi izmēri doti mm, augstuma atz. metros.
2. Parapeta apdare - horizontāli montēts sendvičpanelis KINGSPAN KS 1000 AWP ar sāpju horizontālo šuvi, paneļa b=120mm. Ārējās virsmas tips - Micro, paneļu saslēguma vertikālā šuve nosegta ar detaļu K175a (KINGSPAN sortiments).
3. Membrāna PRO CLIMA SOLITEX WA jālīmē ar 10cm pārklaidumu un jāizolē ar Tescon Invis lentu.
4. Membrāna PRO CLIMA SOLITEX WA jālīmē pamata virspusē.
5. Membrāna PRO CLIMA SOLITEX WA jālīmē parapeta virspusē.
6. Rasējumā dotos izmērus lasīt, ja nepieciešama papildus informācija, bet rasējumā tā nav uzrādīta, vērtības pie ņemta, mērīt rasējumā aizliegts.

Abidzīgais projekts				ARHITEKTU BĪROS SIA "EB" Rīga, Mārupi L-101, L-100B
BPV		RALFS ROZENVALDS		
Arhitektūras daļas vadītājs		RALFS ROZENVALDS		
Arhitekts		ELĪNA ROŽULAPA		
Arhitekta Pasūtītājs	KRISTĪNE KRAKOPE			
Veidots Būvostas pārvalde		Pasūt. N.		
Objekts		VP-EC-12		
Elektronikas centra ēka		Sīdriņa TP		
Kaiju iela 9, Ventspīlī		Lapa ARD-602		
		Mērogs 1:10		
Faiss	Mezglu _ieštrades-2014_01_23.dwg	Atr. reg. Nr.		
Rasējums		Datums		
Savienojums ar esošo ēku, mezglu m', m"		27.01.2014.		